

2023年7月25日
凸版印刷株式会社

大泉洋さん・成田凌さん出演の CM シリーズ最新作
『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN エレクトロニクス篇』
7月25日(火)より公開

凸版印刷株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:磨 秀晴、以下 凸版印刷)は、大泉洋さんと成田凌さんが出演する CM シリーズ最新作『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN エレクトロニクス篇』を、2023年7月25日(火)より公開します。



CMシリーズ最新作『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN エレクトロニクス篇』より

本シリーズは、大泉洋さんと成田凌さんの軽妙な掛け合いを通して、印刷だけではなく、世界中の様々な領域で課題解決に取り組む凸版印刷の姿を知っていただけるよう、2021年4月より展開しています。第10弾となる今回のテーマは「デジタル社会の発展に貢献する『半導体の電子部材製造』」です。

AI や 5G などテクノロジーの進化を受け、さまざまなマーケットにおけるデジタルイノベーションが加速する中、世界の半導体市場は急激な拡大を続けています。

凸版印刷は、1961年に半導体製造において重要な部材であるフォトマスク事業を開始して以来、高い技術力を武器に、日本から欧米、アジアへと製造拠点の拡大を進め、半導体産業の成長を支え続けてきました。フォトマスク(※1)や FC-BGA 基板(※2)をはじめとした半導体電子部材にとどまらず、カラーフィルタやデジタルデバイスをはじめとしたエレクトロニクス事業で、世界のデジタル社会の発展に貢献します。

ガスの保安点検のために、成田さんの住まいを訪れた大泉さん。大泉さんが九官鳥のピーちゃんに言葉を教え込もうとしますが…。2人の掛け合いと合わせて、合いの手を入れるピーちゃんのリアクションにもご注目ください。

■ CMシリーズ最新作『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN エレクトロニクス篇』概要

公開日: 2023年7月25日(火)～ 視聴 URL: <https://youtu.be/NetxNGUmXQc>

テレビ CM 放映開始日: 2023年7月27日(木)～

テレビ CM 放送エリア: 全国 ※一部地域を除く

■ 『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN エレクトロニクス篇』 30秒ストーリーボード



大泉さん：『AI や自動運転などのイノベーションに欠かせない半導体』



大泉さん： ちょっとゆっくり言うね 『AI や…』



成田さん： ちょっと！ウチのピーちゃんに
何覚えさせてるんですか!?

大泉さん： …じゃあコレはどう？



大泉さん： 『TOPPAN は半導体の電子部材製造で
デジタル社会に貢献しています』

成田さん： やめて下さいよ！何ですか、
『TOPPAN は半導体の電子部材製造で
デジタル社会に貢献しています』って！



大泉さん： はははは

あなたが覚えちゃった



NA: TOPPA!!! TOPPAN ♪

■ 特設サイト

最新作をはじめ、これまでの CM シリーズやメイキングムービーをいつでも視聴できます。

URL: <https://www.toppan.co.jp/brand/>

■ 出演者プロフィール

・大泉洋さん



・大泉 洋 (おおいずみ よう)

1973 年生まれ、北海道出身。

演劇ユニット「TEAM NACS」メンバー。深夜番組「水曜どうでしょう」(HTB)にレギュラー出演後、全国放送のドラマに出演。数々のドラマ、映画に出演し、主演作品も多数。「探偵は BAR にいる」(2011 年)、「駆込み女と駆出し男」(2015 年)、「探偵は BAR にいる 3」(2017 年)、「月の満ち欠け」(2022 年)等で日本アカデミー賞優秀主演男優賞をはじめ、映画に関する賞を数多く受賞。

映画「こんにちは、母さん」が 2023 年 9 月 1 日に公開される。

・成田凌さん



・成田 凌 (なりた りょう)

1993 年生まれ、埼玉県出身。

主な出演作品に「劇場版コード・ブルー - ドクターヘリ緊急救命 - 」「スマホを落としただけなのに」(2018 年)、「愛がなんだ」「さよならくちびる」「人間失格」映画初主演「カツベン!」(2019 年)、「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」「糸」「窮鼠はチーズの夢を見る」(2020 年)「まともじゃないのは君も一緒」「くれなずめ」「竜とそばかすの姫」(2021 年)「ニワトリ★フェニックス」「コンビニエンス・ストーリー」(2022 年)、舞台「パンドラの鐘」「宝飾時計」他。

関西テレビ「転職の魔王様」毎週月曜日よる 10 時より放送中。

※1 フォトマスクは LSI など集積回路の製造工程で使用される重要部材です。表面の遮光膜にごく微細な回路パターンをエッチングした透明なガラス板で、回路をシリコンウェハに焼き付けるときの原版になります。フォトマスク上のパターンをシリコンウェハ上に縮小露光することにより微細なパターンを形成します。回路パターンデータを元に電子ビーム描画技術によってフォトマスク基板上にマスクパターンを形成し、その後エッチング・レジスト剥離・洗浄・測定・検査を経てフォトマスクが完成します。トッパンは、1961 年よりフォトマスクの製造を通じて半導体産業の発展を支えてきました。近年では、進展する LSI の微細化に対する位相シフトマスクや、次世代露光技術に対するフォトマスクの開発も進めています。

※2 FC-BGA (Flip Chip-Ball Grid Array)基板は、LSI チップの高速化、多機能化を可能にする高密度半導体パッケージ基板です。トッパンは、微細加工技術とビルドアップ配線板技術を独自に発展させた超高密度配線構造の基板を開発、半導体プロセスの微細化に対応した製品を提供しています。PC やゲーム機向けのマイクロプロセッサやグラフィックプロセッサをはじめ、サーバー、AI、ネットワーク機器向けのハイエンドプロセッサ、高品質の車載用 SoC など、幅広い用途向け LSI の多彩な要求に対し、基板の設計から製造までお客様のニーズをトータルにサポートします。

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上